デジタル社会に貢献する

メック株式会社

東証プライム市場　4971

2025年3月29日（土）

本日の内容

- 2024年12月期業績について
- メックについて
- 今後の動向について
- 中期経営計画Phase2について

2024年12月期 総括

事業環境

2024年度は、データセンターにおいて、生成AI関連がけん引役となり先端分野への投資堅調、従来分野においては緩やかに回復基調へと転じる動き。コンシューマー向けのパソコンやスマートフォンも緩やかに回復基調。回復の勢いは力強さを欠くが、デジタル技術進展のメガトレンドは不変。

決算概況

前期比 増収増益　売上高、営業利益ともに過去最高を更新。

主要製品概況

CZ　：生成AI関連など先端パッケージ基板向け製品需要拡大。
　汎用サーバーやパソコン向け製品需要は力強さ欠けるものの回復基調。

V-Bond：車載基板向けや衛星関連基板向けに堅調。

EXE　：関連する電子機器の在庫調整一巡による需要回復が見られ増加。

SF　：関連する電子機器の生産動向を受け増加。

2024年12月期 業績概要

項目	FY2023（実績）	FY2024（実績）	FY2024 前期比	
	（百万円）	（百万円）	（百万円）	（%）
売上高	14,020	18,234	4,214	30.1
営業利益	2,492	4,562	2,069	83.0
営業利益率	17.8%	25.0%	7.2pt	-
経常利益	2,683	4,682	1,999	74.5
当期純利益	2,304	2,291	△ 13	△ 0.6
1株当たり当期利益（円）	122.29	122.38	-	-

会社概要

（2024年12月31日現在）

社　　名	メック株式会社　MEC COMPANY LTD.
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び　機械装置、各種資材の販売
代　表　者	代表取締役社長　前田　和夫
資　本　金	5億9,414万2,400円
連結売上高	182億34百万円
上場市場	東証プライム市場（4971,化学）
従業員数	連結480名（単体277名）

株主構成（所有株式数）

	2023.6	%	2023.12	%	2024.6	%	2024.12	%
個　　人	5,139,472	25.6	5,551,958	27.7	4,494,753	22.4	5,449,991	27.2
金融機関	7,682,329	38.3	6,466,029	32.2	7,222,629	36.0	7,001,229	34.9
国内法人	1,633,196	8.1	1,605,916	8.0	1,594,803	7.9	1,589,729	7.9
外 国 人	3,807,883	19.0	4,841,354	24.1	5,050,026	25.2	4,530,395	22.6
証券会社	626,371	3.1	423,924	2.1	526,970	2.6	317,837	1.6

*%は小数点第2位を四捨五入しています
*自己名義株式は含みません

社名

Machinery
Electronics
Chemistry

「機械」「電子」「化学」を
融合させた総合技術で社会に挑む

社是と経営理念

仕事を楽しむ

『 独創の技術 』
『 信頼の品質 』
『 万全のサービス 』

わたしたちは
「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、
自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を
実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します

メックとは

- 主に、電子基板・部品製造時に使用される“**薬品**”を開発・製造販売
- 研究開発型企業。単体従業員の約1/3が研究開発に携わる
- 主として金属（特に銅）を溶かす技術
  銅を溶かし、さまざまな付加価値を高める
- 半導体後工程部材である、半導体を搭載する「有機パッケージ基板」の銅を溶かす工程において独占的シェア
- 世界中どの生産拠点でも同品質の製品を提供できる生産体制

⚠ **基板メーカーではなく、めっき用薬品の製造もしていない** ⚠

製品の流れ

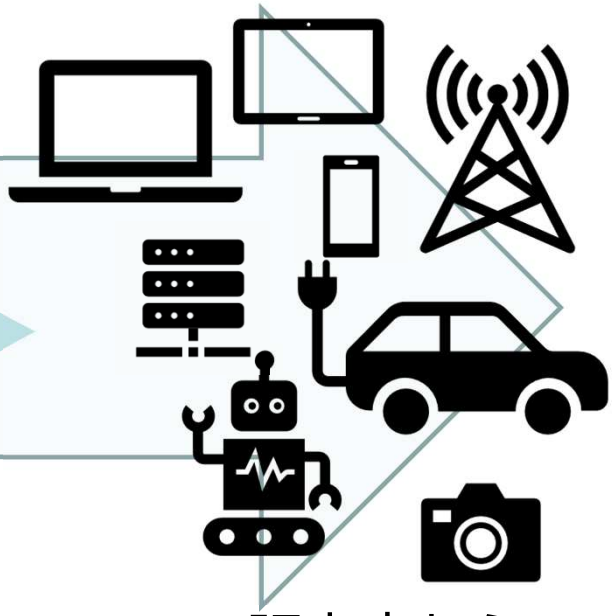
決定された開発テーマ、仕様に基づき、
結果が得られるまで徹底的に実験

研究開発から**配合表**

研究開発から出てきた配合表を
もとに薬品を製造

当社工場で製品を生産

基板メーカー
部品メーカー



販売店から
皆さまのもとに

拠点

メックヨーロッパ
［ベルギー］

メック蘇州

メック珠海

メックタイ

メック台湾

MEC
（日本）

メック香港

本社
尼崎事業所
（研究所・工場併設）
兵庫県尼崎市
2017年～

本社
東初島事業所
（研究所併設）
兵庫県尼崎市
2020年～

長岡工場
新潟県長岡市
1993年～

東京営業所
東京都立川市
1974年～

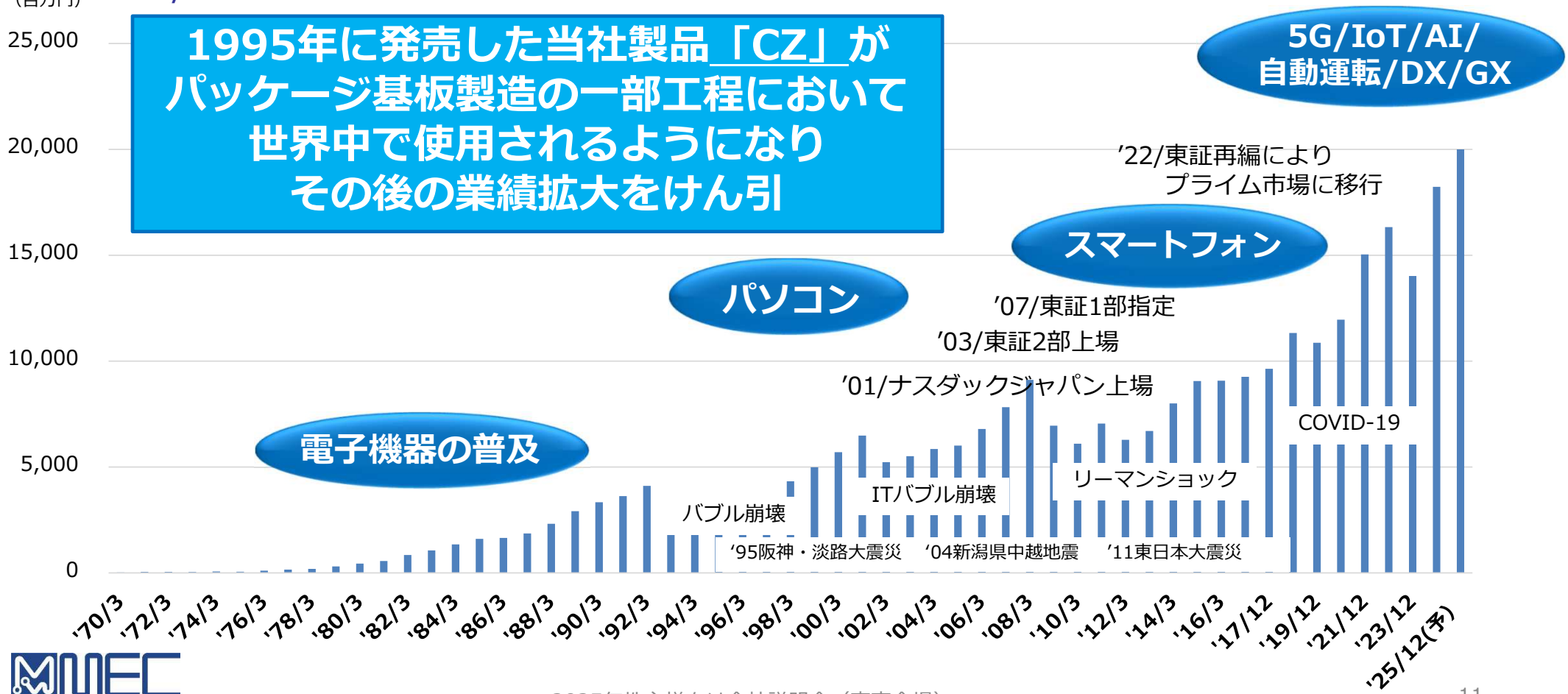
北九州工場（仮称）
2026年稼働予定
福岡県北九州市若松区

海外子会社　工場

創業からのあゆみ

1969/5　大阪市北区に化学技術コンサルタント会社としてスタート
1970/2　電子基板用薬品製造に着手

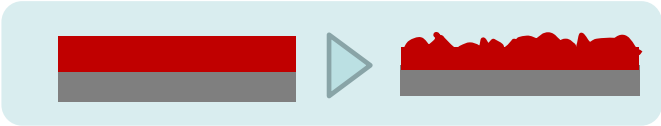
1995年に発売した当社製品「CZ」が
パッケージ基板製造の一部工程において
世界中で使用されるようになり
その後の業績拡大をけん引



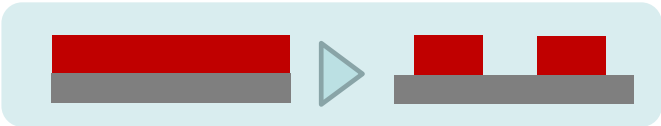
コア技術

界面価値創造

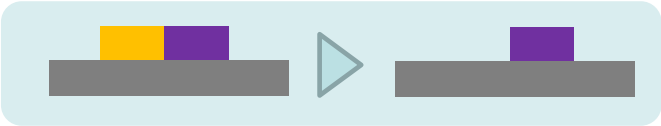
- 表面を粗化し、
  機械的に密着性を向上
  CZ、V-Bond



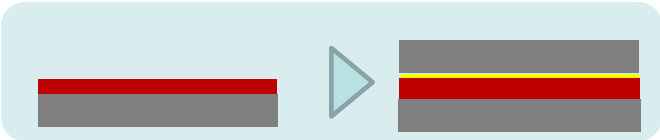
- 配線を形成する
  EXE



- 選択エッチング
  SF



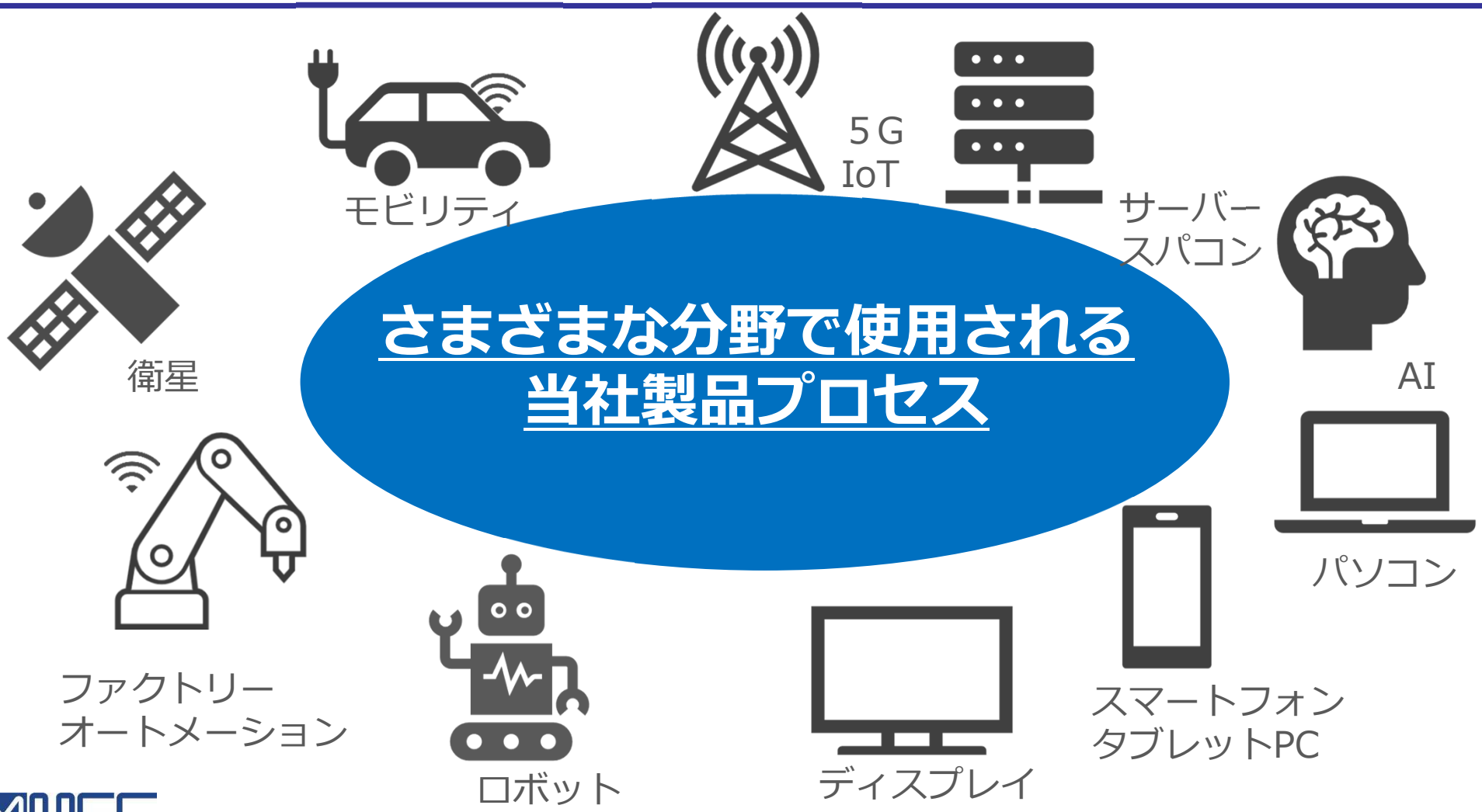
- 表面を処理し、
  化学的に密着性を向上



主要薬品用途と最終製品例

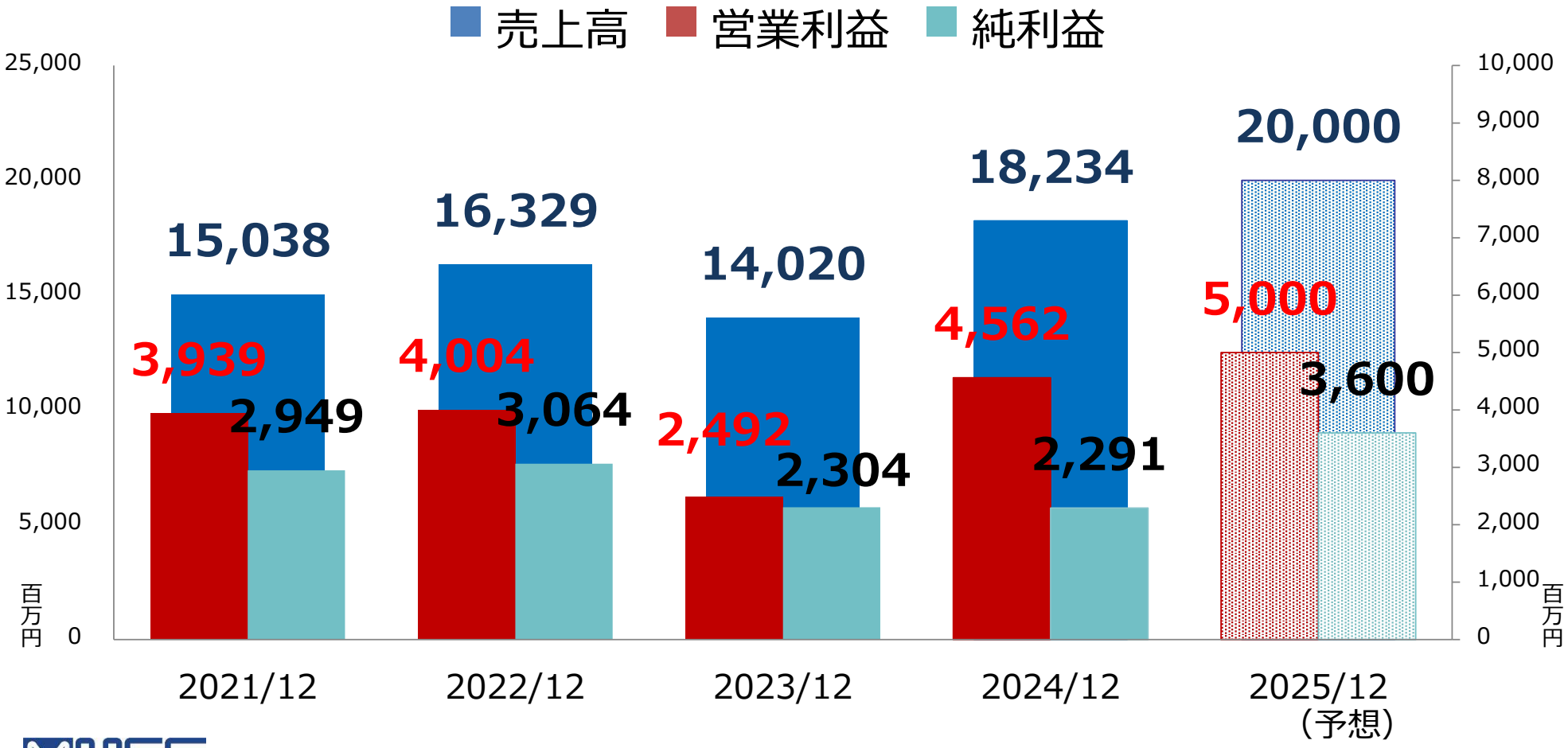
主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 主にパッケージ基板向けの密着向上剤で、高密度電子基板にも使用される。	生成AI関連、5G/6G関連・データセンター等の通信インフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、 パッケージ基板には使用されない。	クルマ、スマートフォン、 衛星通信等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤で使用されている。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

活躍できる分野



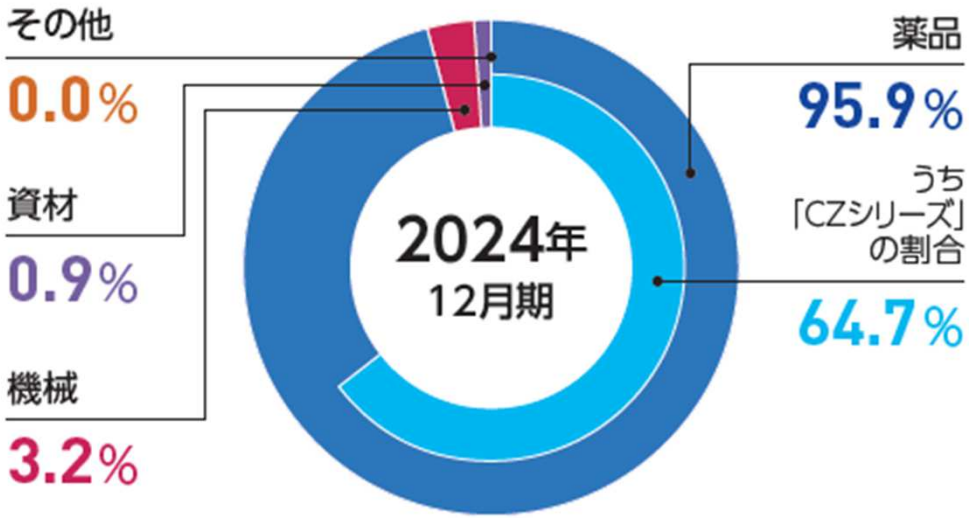
さまざまな分野で使用される
当社製品プロセス

連結業績推移

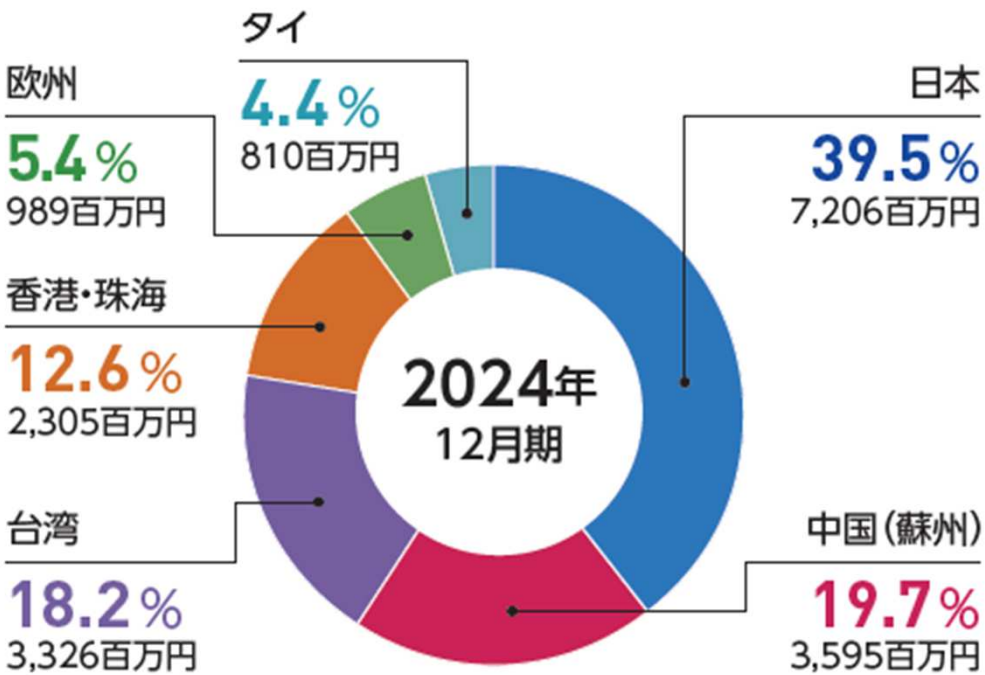

売上高
営業利益
純利益
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
百万円
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
百万円
15,038
3,939
2,949
16,329
4,004
3,064
14,020
2,492
2,304
18,234
4,562
2,291
20,000
5,000
3,600
2021/12
2022/12
2023/12
2024/12
2025/12
（予想）

売上構成

売上高に占める品目別割合



地域セグメント別売上高と比率



＊比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません

成長のキーワードと売り上げ拡大のステップ

次世代通信ネットワーク

- 5G/6G、光通信、衛星通信等

IoT・AI

- あらゆるものがネットでつながる
- DX、エッジAI、医療等

次世代モビリティ

- 電気自動車
- 運転アシストシステム等

世界的な
半導体需要の増加

↓

半導体メーカーの
巨額な投資

↓

PKGメーカーの
大きな投資

↓

メックの成長

新拠点

北九州工場（仮称）

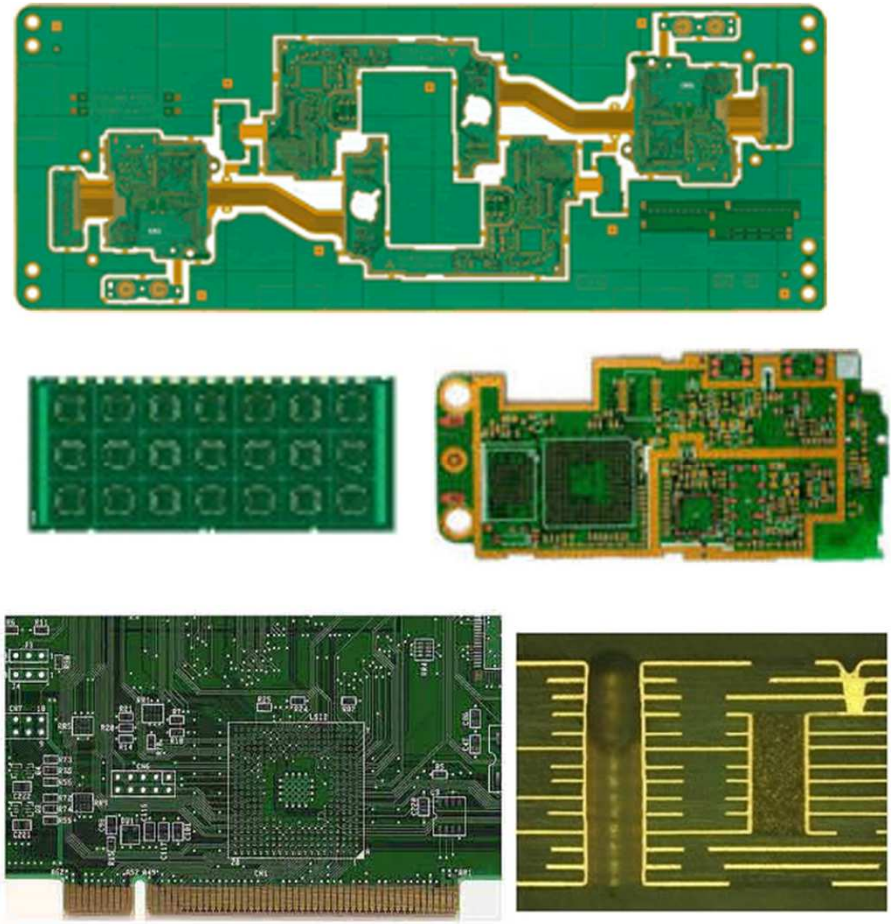
福岡県北九州市若松区向洋町

土地面積約３万平米を取得し
2026年12月稼働を目指し進行中

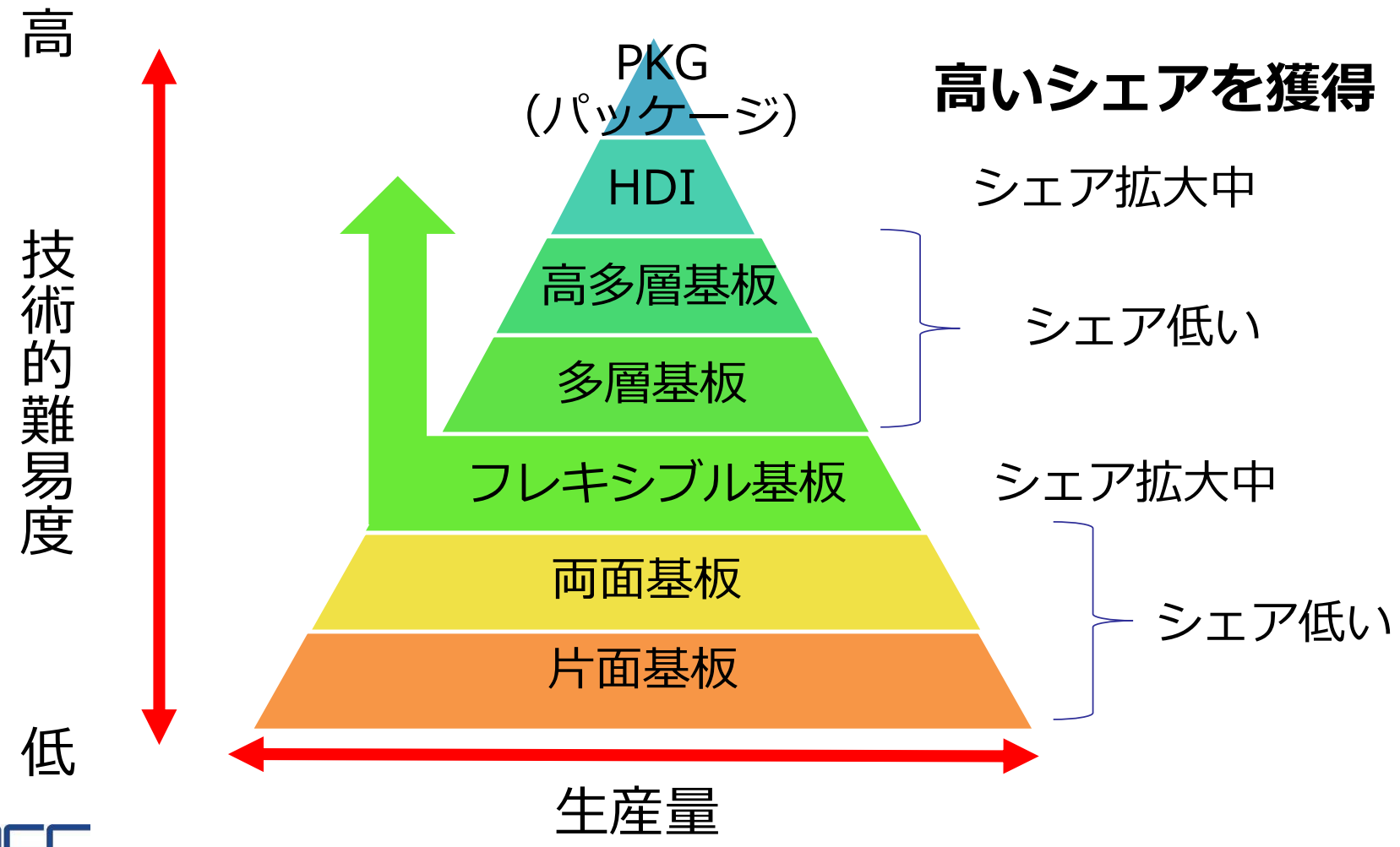
電子基板とは

電子基板は、
家電、通信機器、医療機器から
飛行機や自動車産業機器まであ
らゆる分野で使用されています。

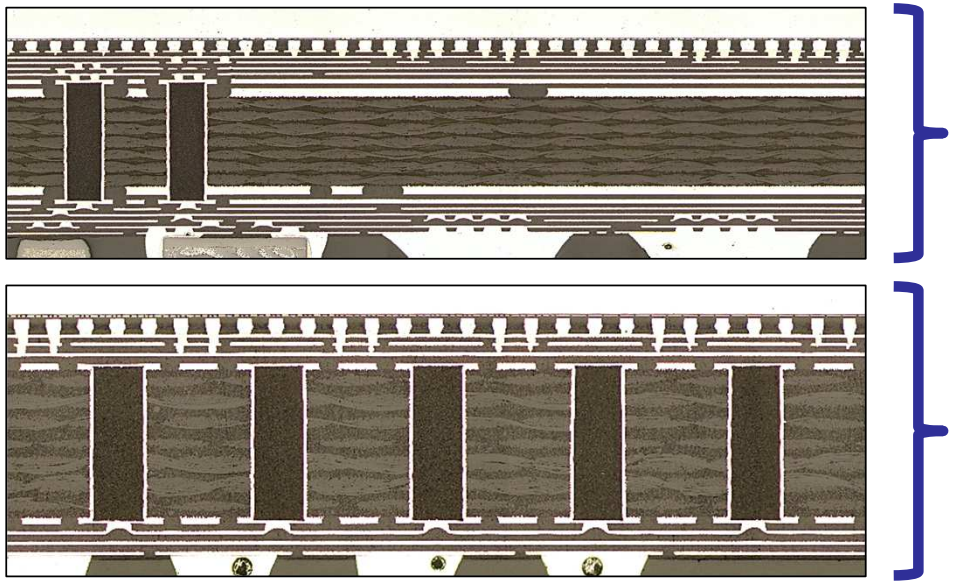
当社は、
私達の暮らしに欠かせない
電子基板の製造の過程で使用
する薬品・機械を開発し
皆様にお届けしています。



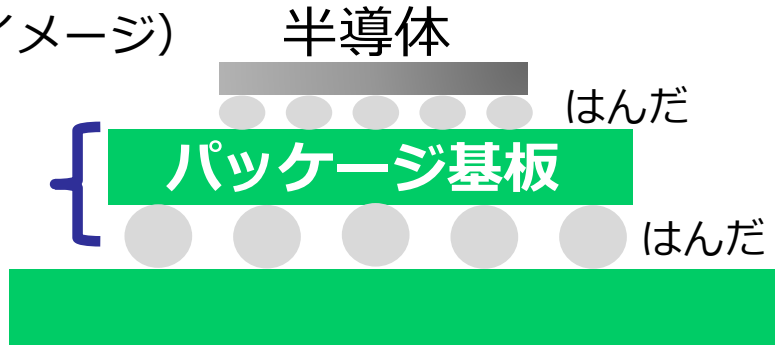
メックが強い領域


高
技術的難易度
低
PKG
(パッケージ)
HDI
高多層基板
多層基板
フレキシブル基板
両面基板
片面基板
生産量
高いシェアを獲得
シェア拡大中
シェア低い
シェア拡大中
シェア低い

パッケージ（PKG）基板

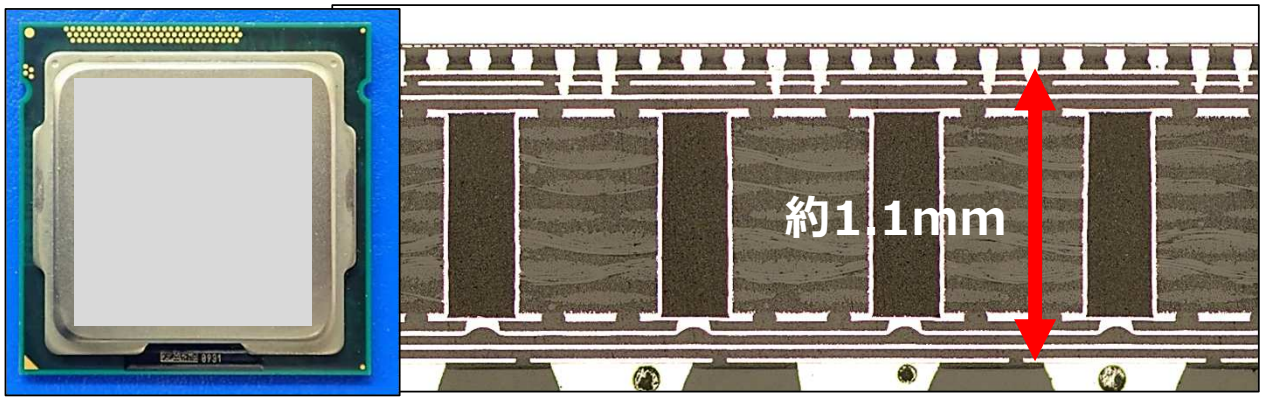


（イメージ）

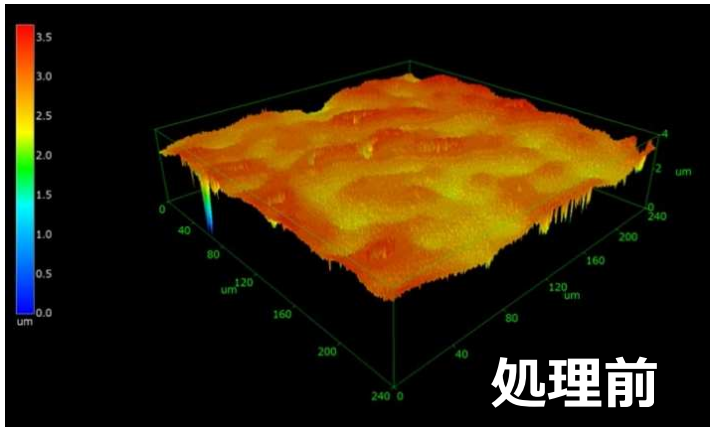


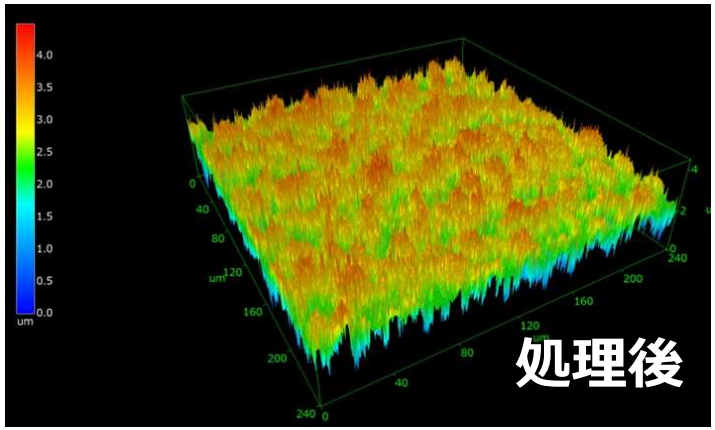
半導体は**nm**ルール
電子基板は**μm**ルール
1mm＝1,000**μm**
1mm＝1,000,000**nm**

PKG基板とCZ



(10円硬貨の厚みは1.5mm)

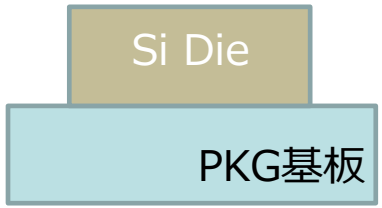




- **PKG基板**は半導体を搭載するために必要
- PKG基板の白い部分が銅配線、暗い部分が絶縁樹脂主に、層になっている銅の部分で、当社の「CZシリーズ」が使用される
- CZ処理で銅表面を微細な凹凸形状にし、銅と樹脂との密着性を大幅に向上するため剥がれない！！
  (銅と樹脂の剥がれはエラーに)

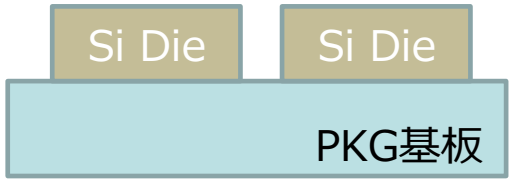
PKG基板の進化

通常のPKG



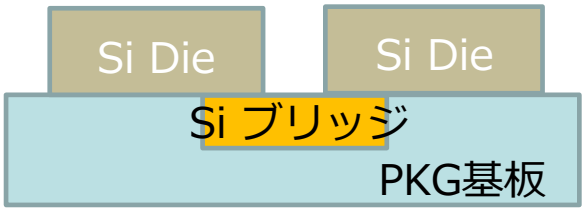
一つのPKGに
一つの半導体

Chiplet

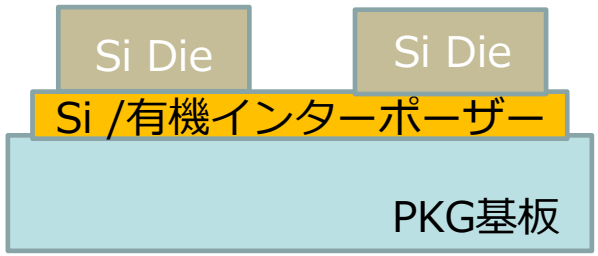


PKGを大きくし
複数の半導体を搭載

EMIB
(**E**mbedded **M**ulti-die **I**nterconnect **B**ridge)



CoWoS
(**C**hip **o**n **W**afer **o**n **S**ubstrate)

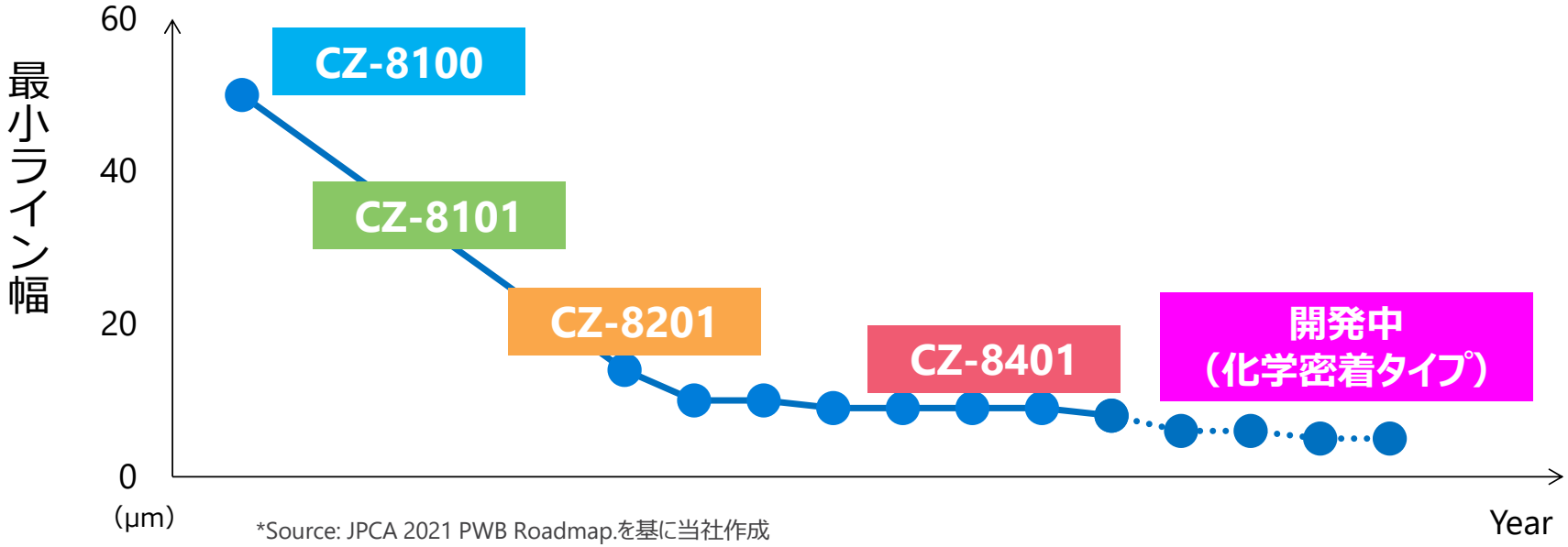


EFB
(**E**levated **F**anout **B**ridge)

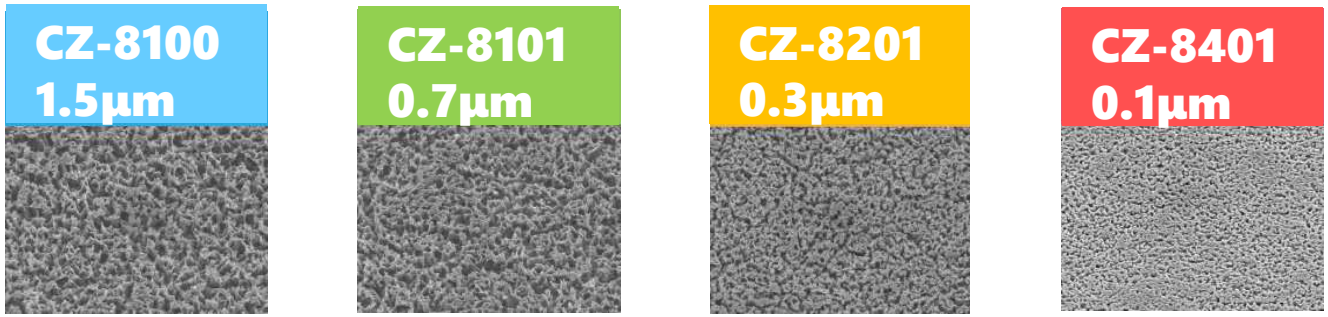
銅ピラー

PKG基板 ⇒ サイズ大型化、層数増加

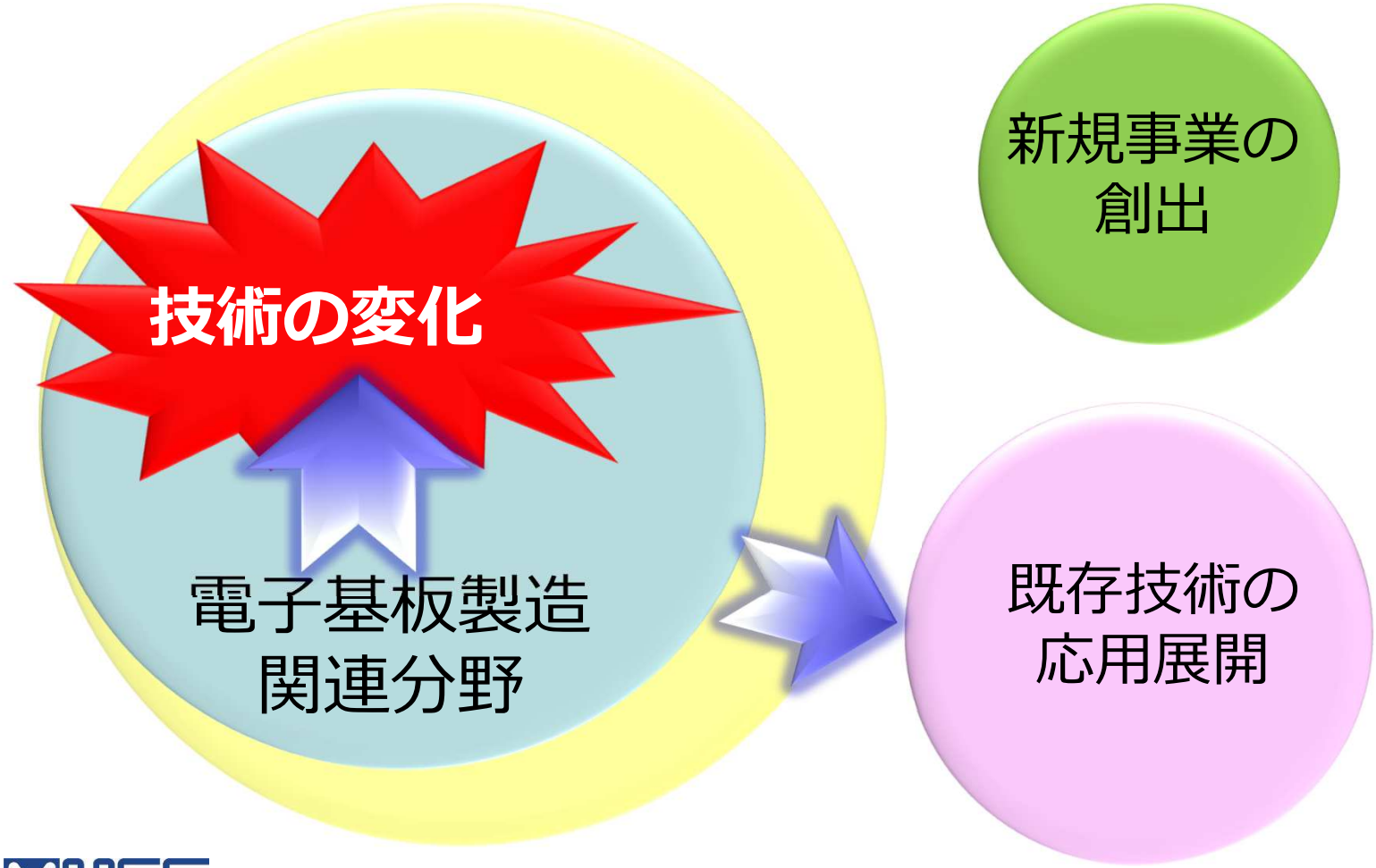
CZシリーズのロードマップ



*Source: JPCA 2021 PWB Roadmap.を基に当社作成



事業領域の拡大を目指して



メック株式会社
証券CODE:4971

2030年ビジョン
Phase 2

中期経営計画
（2025–2027）

2025年２月14日

ミッションとビジョン

界面から、世界を変える

界面の創出と接合で
世界一になる

目指す企業像

独創の技術で新たな価値を創造する

真のグローバルカンパニーになる

研究開発型企業であり続ける

独創のAI企業としての顔をもつ

2030年の社会

通信情報革命により、
デジタル技術が急速に発達する。

次世代通信ネットワーク	5G/6G、光通信、衛星通信
IoT	あらゆるものがネット接続
AIの多様化	情報処理に人工知能を応用、DX
次世代モビリティ	自動運転車、自動運転アシストシステム

持続的な取り組み

事業活動を通じ、社会課題解決に貢献できる
製品・技術を世に提供します。

事業

- 未来を切り開く研究開発
- 環境負荷低減製品の開発
- 適正の調達、生産、物流

環境

- 気候変動対応
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 品質保証

社会・労働

- 労働安全・健康経営
- ワークライフバランス
- キャリア形成
- ダイバーシティ
- エンゲージメント

ガバナンス

- コーポレート・ガバナンスの強化
- リスクマネジメント強化
- コンプライアンスの徹底
- 情報セキュリティ

本中期経営計画（Phase2）の位置づけ

2030年に目指すべき企業像に向けて、
3カ年中期経営計画を3期かけ、
持続的成長と企業価値の最大化を目指します。
2期目である本中期経営計画は
成長への礎づくりに取り組みます。

2030年ビジョン

界面の創出と接合で世界一になる

Phase 1

2022～2024年
コア事業の強化
・重点領域の深耕
・収益性確保し成長への投資

Phase2

2025～2027年
成長への礎づくり
・新技術での地位確立
・既存技術を応用した事業構築

Phase3

2028～2030年
さらなる成長へ
・新規事業の創出

ESG経営の推進・強化

当社を取り巻く事業環境の変化

急激なテクノロジーの変化

環境規制の強化

米中貿易摩擦の激化

チャイナ・プラスワンへの製造業の移行

▼

進化するデジタルテクノロジーとの共生に向け
技術需要の高まりとニーズの多様化を背景に
半導体関連市場は拡大が見込まれる

当社における重要機会

拡大する市場

次世代通信ネットワーク
(5G/6G、光通信、衛星通信)

IoT
(あらゆるモノがネット接続)

AIの多様化
(DX、エッジAI、医療等)

次世代モビリティ
(自動運転車、運転アシストシステム等)

コア事業の**市場拡大**
(半導体、電子基板市場)

×

求められる技術

高速情報処理

低電力消費

小型化

信号低損失

高集積ニーズ拡大

超微粗化、無粗化技術による
密着向上剤の需要拡大
(信号高速化、高密度化)

Phase2（2025年～2027年） 目標

定量目標

連結売上高

2027年

250億円

（コア事業　235億円
応用展開　15億円）

連結営業利益率

20%以上

ROE

10%以上

定性目標

既存市場における収益性維持・強化

- 顧客との関係性強化
- 超微粗化系密着向上処理のシェア維持
- 無粗化技術（化学密着）領域における ソリューション確立
- 環境配慮薬品への取り組み

既存技術の応用展開分野における事業構築

新規事業の創出

グローバル安定供給体制の確立

ESG経営の推進・強化

人的資本基本方針

挑戦できる企業風土の実現	多様な個性・価値観を有する人財が、自立自走・連帯のもと、「創造と変革」に挑戦できる企業風土を醸成します。
キャリア形成と能力開発支援	従業員一人ひとりの持続的成長のために必要な教育・研修機会を提供し、キャリア形成と能力開発を支援します。
ダイバーシティの推進	「多様な人財の獲得」「公正な評価で報いる人事制度の構築」「効果的な人財配置を実現するタレントマネジメントシステムの充実」による、働き甲斐のある労働環境づくりに取り組みます。
従業員エンゲージメントの向上	多様な人財を受容する制度整備・意識変革を推進し、ワークライフバランスの充実による、従業員エンゲージメントの向上を実現します。
良好な社内環境の構築	従業員一人ひとりが心身ともに健康で、安全にいきいきと働き続けることができる良好な社内環境を構築します。

資本政策

MNEC

研究開発に関する投資

毎年
連結売上高の

約 **10** %

設備投資

3カ年累計

約 **80** 億円

株主還元

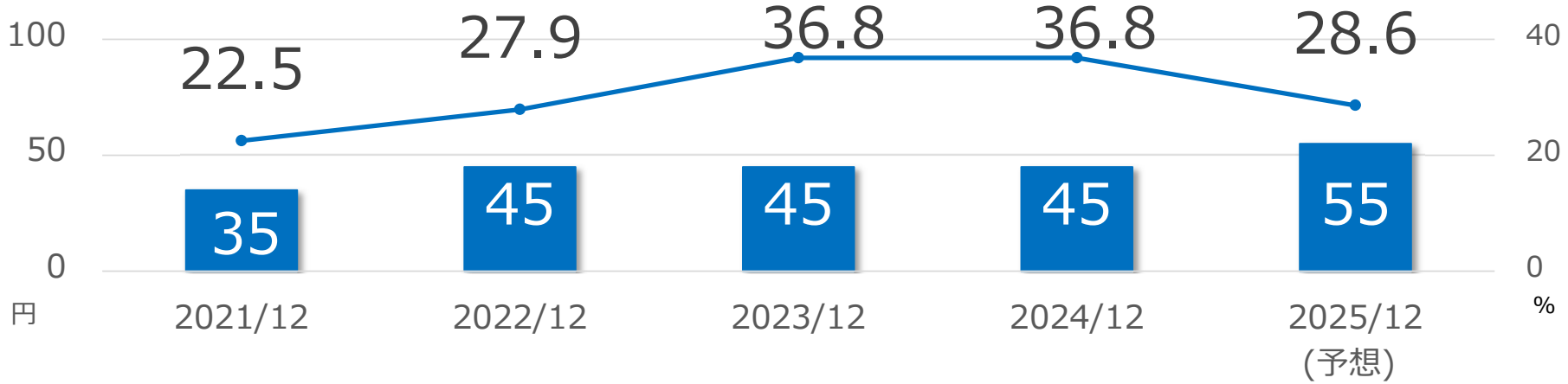
1株当たり年間配当金
の
維持・成長

連結配当性向：**30**%目標

自己株式取得は
状況に応じ機動的に実施

株主還元

■配当金推移



■自己株式取得

- 2023年 6月 286,000株
- 2018年12月 200,000株
- 2017年 3月 200,000株
- 2016年 3月 140,000株
- 2015年11月 500,000株
- 2009年 2月 300,000株

■株主優待

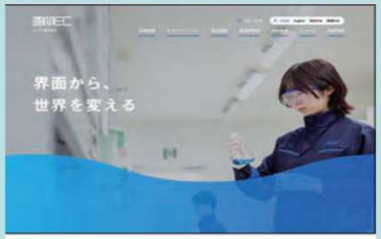
1,000株未満 QUOカード1,000円分
1,000株以上 QUOカード2,000円分

※毎年12 月31 日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100 株（１単元）以上保有の株主様が対象

ご清聴ありがとうございました

このプレゼンテーション資料には、2025年3月29日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

メック株式会社

https://www.mec-co.com/

当社のホームページでは「プレスリリース」、「株主通信」、
「サステナビリティ報告書」、「コーポレート・ガバナンス報告書」他、
各種情報を掲載しています。ぜひご覧ください